令和8年度
デジタル技術基盤分野研究会
第4回 技術セミナー

参加費
無料

半導体後工程・先端実装の最新トレンドと日本の勝機
～生成AI・EV時代に求められる熱対策と材料技術～

自動車自動運転から Physical AI へ、全てを自律的に電動制御する時代がやってくる。その土台となるのが、AIを担う半導体（先端、アナログ、センサ等）とパワー半導体である。AIパフォーマンスは当然のことながら、同時に壊れないこと、省ネルギーであること、更には広く普及を妨げないコストが最適化されていることが求められる。

パッケージ技術はその基本を支え、特に日本が世界を先導するべき半導体産業の将来を支えることが期待されている。

■日時：令和8年 **11月12日（木）**
14:00 － 15:30

■開催方法：
Zoomウェビナーを使ったライブ配信
（注意：会場での視聴は、ありません。）

■募集人員：先着100名

■対象者：　デジタル技術基盤分野研究会
会員企業、大学等の研究機関の方等



講師
大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所
所長 / 特任教授
菅沼 克昭 氏

■申込み方法：
・次のURLあるいはQRコードのフォームから申込みください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eO7BUz7qQCSWlt1bfEEeRw
・デジタル技術基盤分野研究会への新規入会ご希望の方は、
「裏面：入会申込書」 で申込みください。（FAX，Eメール、電話でも可）

お問合わせ　（公財）富山県新世紀産業機構
イノベーション推進センター
TEL：076-444-5636　FAX：076-433-4207
E-mail：y.mizuno@tonio.or.jp（ 担当：水野 ）

講師

菅沼 克昭 氏
(すがぬま かつあき)

プロフィール

【学歴】
1977年　東北大学工学部原子核工学科卒
1982年　同博士課程修了
【職歴】
1982～1986年　大阪大学 産業科学研究所 助手
1986～1996年　防衛大学校 助教授
1996～2020年　大阪大学 産業科学研究所 教授
2018～2020年　大阪大学 産業科学研究所 所長
2019年～　大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 所長
2023～2025年　LSTC 3Dパッケージ技術部門長
2025年～　一般社団法人 日本OSAT連合会 顧問

【研究歴】
鉛フリーはんだ、導電性接着剤、セラミックス接合、プリンテッドエレクトロニクス、パワーエレクトロニクス実装などの基礎から応用研究などに取り組み、これらの国際標準化を含め国家プロジェクトを推進している。
現在、大阪大学で先端車載AI半導体ワーキングやWBG実装ワーキングを主催し、JEITA IEC/SC47D(半導体パッケージング)国内委員会などの標準化国内委員会委員長を務める。 論文数450編、著書20編

【受賞歴】
平成5年科学技術庁長官賞研究功績者
The Richard M. Fularth Pacific Award
平成24年経済産業大臣表彰（工業標準化事業表彰）
平成26年エレクトロニクス実装学会賞
令和3年文部科学大臣賞（科学技術賞研究部門）など

デジタル技術基盤分野研究会入会申込書

（入会希望の方は、下記に記入ください。）

デジタル技術分野関連産業にご興味や、新たに事業参入・利活用への意欲のある企業・団体等に所属される方が対象です。
必要事項をご記入の上、e-mail 又は FAX にてお申込みください。
（セミナーの開催案内や、ロボットに関する情報提供をさせていただきます。登録人数に制限はありません。）
研究会加入申込書（加入希望者の方のお名前等をご記入ください）
※ご記入頂いた事項は、当該事業の運営の為のみに使用し、他の目的には使用しません。

企業名・団体名			
所在地	（〒　　）		
連絡担当者		FAX	
TEL		E-mail	
会員希望者名			
E-mail		FAX	
所属部署		職位・職名	
会員希望者名			
E-mail		FAX	
所属部署		職位・職名	

■お申込み・お問合せ先　FAX: 076-433-4207　E-mail: y.mizuno@tonio.or.jp